KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Termopad SP150-G4-0.9

Ostatnia aktualizacja 20.01.2020r

Podkładka termoprzewodząca SP150-G4-0.9 to kompozyt łączący folię izolacyjną (poliimidową) z elastomerem o wysokiej przewodności cieplnej. Dzięki swojej wysokiej przewodności cieplnej, izolacyjności i łatwości użycia znalazł szerokie zastosowanie przy odprowadzaniu energii cieplnej w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych takich jak: radiatory, moduły grzewcze w pojazdach, sprzęt AGD, elektronika użytkowa. Charakteryzuje się ponadto doskonałą odpornością mechaniczną na ścieranie i przebicia odpornością ogniową potwierdzoną certyfikatem UL-94 V-0 oraz bardzo wysokim napięciem przebicia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Przewodność cieplna (ASTM D5470)	0,9 [W/m*K]
Twardość (ASTM D2240)	90 [Shore A]
Grubość (ASTM D374)	0,15 [mm]
Kolor	Szary
Gęstość (ASTM D792)	1,6±0,1 [g/cm^3]
Temperatura pracy	-40 do +200 [°C]
Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D412)	≥32 [MPa]
Napięcie przebicia (ASTM D149)	≥6 [kV]
Rezystywność (ASTM D257)	≥1*10^{12} [Ω*cm]
Wytrzymałość ogniowa (UL-94)	V-0
Materiał samoprzylepny	Wg specyfikacji klienta
ROZMIAR	
Długość	Wg specyfikacji klienta [mm]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

INDUCOMP SP. Z O.O., ul. Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin
biuro@inducomp.pl; www.inducomp.pl